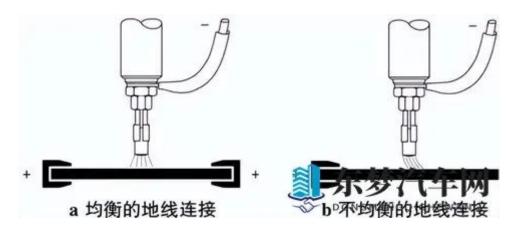
# 薄板短周期螺柱焊虚焊问题成因与防治策略

来源: 黄俊映 发布时间: 2025-11-22 23:21:59

短周期拉弧螺柱焊作为一种高效、经济的连接工艺,广泛应用于汽车车身制造中薄板类零件的连接。然而,在进行螺柱焊接时,在厚度小于0.7mm的薄板上进行焊接时,虚焊(Incomplete Weld/Lack of Fusion)缺陷频发,严重影响接头强度和生产质量。根据行业标准,薄板螺柱焊接的虚焊率应控制在<0.04%,但实际生产中常因多因素耦合而超标。本文基于文献研究与实践数据,系统分析虚焊成因,并提出综合工艺优化建议。

# 一、虚焊问题成因分析

虚焊本质上是焊接接头未形成充分冶金融合的现象,其成因复杂,主要可归纳为以下几个方面:

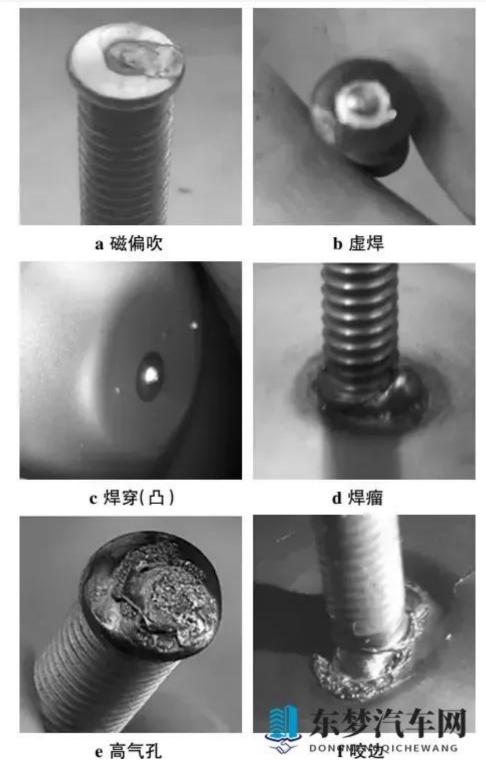


### 1. 磁偏吹导致的电弧不稳定

磁偏吹是短周期拉弧螺柱焊中的常见问题,指电弧因磁场分布不均而偏离螺柱轴线的现象。通过对前地板薄板螺柱焊缺陷的统计分析,磁偏吹是导致螺柱脱焊的主要原因,占比高达81%。磁偏吹会使电弧能量分布不对称,导致螺柱一侧熔深不足而另一侧过熔,形成虚焊或气孔缺陷。

上图显示了磁偏吹引起的典型缺陷,如偏弧、单侧焊缝缺失等。

磁偏吹的诱因包括:



螺柱尺寸偏差:焊接端锥角或引弧球尺寸不标准,导致电流偏离中心。零部件形状不对称: 异形零件加强磁场不均匀性,吸引电弧偏移。地线接法不当:地线位置不均衡会造成电流分布畸变,加剧磁偏吹。2. 板材定位与垂直度偏差

薄板(如0.7mm DC04钢)刚性差,在焊接过程中易因夹具压紧不足发生晃动或偏移。板材定位不稳定会破坏螺柱与母材的垂直度,导致电弧能量分布不均。倾斜状态下,熔池形成不一致,有效融合面积减少,引发虚焊。同时,焊枪提升高度(Lift Height)波动会进一步造成弧长不稳定,若弧压波动超过±10%,焊点强度显著下降。







## 3. 薄板局部厚度不均

冲压成型过程中, 薄板局部区域(如弯角处)可能因塑性变薄至0.45-0.50mm(减薄率 达23%)。原焊接参数基于标称厚度设计,在变薄区域易导致过熔或击穿,反而抑制冶金结 合,形成"假焊"。热输入与板材厚度不匹配是虚焊的重要诱因。

# 4. 背面支撑不充分与热传导失衡

薄板焊接时,若背面缺乏刚性支撑,板材在电弧热作用下发生鼓包变形,改变螺柱与工 件的相对位置,影响弧长和热分布。支撑不足会导致热量积聚,形成"热点效应",使焊核 冷却异常,晶粒粗大,降低接头强度。

上图显示采用非磁性材料(如黄铜)的支撑结构可有效抑制变形和磁干扰。

### 二、工艺优化建议

为系统性降低虚焊率, 需从工装设计、工艺参数和过程控制多维度优化:

1. 强化背面刚性支撑与接地设计采用定制化支撑块: 在焊接区域背面设置黄铜或高温铜合 金支撑块,提供全接触贴合,增强板材刚度。支撑块应带通孔结构(孔径略大于螺柱直 径2-3mm),以平衡热传导和熔池膨胀。优化地线布局:实施多点弹性接地,确保焊枪位于 地线中间位置,消除电流分布不均。2. 引入防飞溅保护套与预压紧机制使用硅胶/陶瓷防飞 溅套: 扩大板材接触面积, 抑制焊接过程中的振动和局部凹陷, 提升弧长稳定性。此装置还 可延长焊枪寿命,便于自动化维护。3. 精细调控焊接工艺参数

基于实践数据,针对M6螺柱焊接0.7mm薄板,推荐参数:

提升高度: 1.2-1.3mm(避免过高导致电弧漂移或过低引发短路)。焊接电流与时间: 主电 流520A, 主焊接时间16ms: 预焊接电流80A, 预焊接时间50ms。动态参数调整: 对厚度偏低 区域(<0.55mm),采用脉冲焊接模式或微降电流峰值,实现能量精准匹配。4. 建立厚度检 测与差异化焊接策略实施超声波测厚:对冲压件关键区域抽检,生成厚度分布图,对变薄区 标记并调整参数。加强夹具防磁化设计:采用非磁性材料(如塑料、铝)制作夹具组件,减 少剩磁对电弧的干扰。5. 过程监控与质量验证引入弧压实时监测: 控制波动在±10%以内,

确保热输入稳定。强化焊后检测:通过扭力试验、弯曲试验和锤检法验证焊点质量。优化后焊瘤和气孔显著改善,脱焊率从4%降至合格水平。

短周期拉弧螺柱焊在薄板螺柱焊接中的虚焊问题,根源在于磁偏吹、板材变形、厚度不均及工装支撑不足等多因素交互作用。通过综合采用刚性支撑结构、优化地线布局、参数精细调控及厚度适应性策略,可有效提升焊接稳定性。实践表明,上述措施能将虚焊率控制在行业先进的<0.04%以内,满足汽车制造的高标准需求。未来,需进一步融合智能传感与自适应控制技术,实现焊接过程的动态优化。欢迎各位老铁留言探讨!

HTML版本: 薄板短周期螺柱焊虚焊问题成因与防治策略